

トッフルチナCP/SV/SD

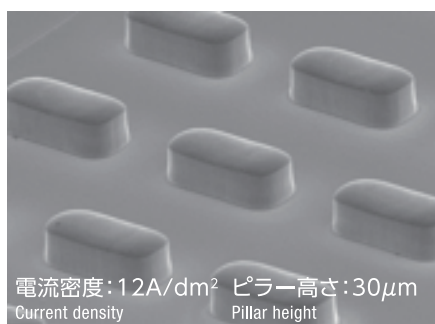
TOP LUCINA CP/SV/SD

銅バンプ形成用
For copper bump formation

トッフルチナCP

TOP LUCINA CP

- 高電流密度対応(8~12A/dm²)
Applicable to high current density
- 良好なパターン形状を実現
Form uniform, fine pattern shape



高速めっきが可能で、
銅ピラー等の形成に最適

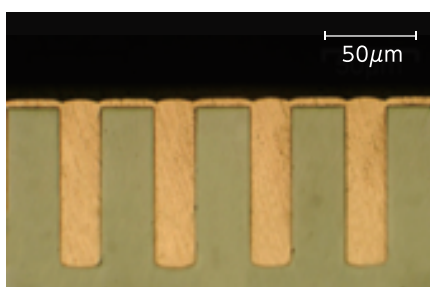
High-speed plating is possible,
the best for forming copper pillars etc.

TSVフィリング用
For TSV filling

トッフルチナSV

TOP LUCINA SV

- 高アスペクト比ビアの
フィリングが可能
Realize great via-filling
under high aspect ratio



TSV形成用途だけでなく、
高アスペクト比トレンチへの
埋め込みにも対応

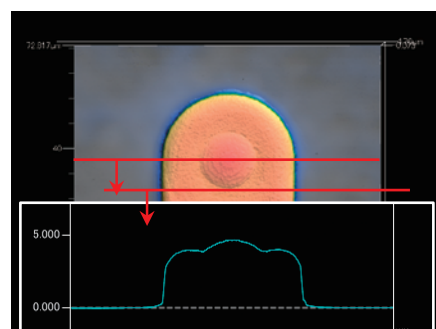
Can be used for TSV, also for
trench filling under high aspect ratio

低アスペクト比ビアおよびトレンチフィリング用
For low aspect ratio via-, trench-filling

トッフルチナSD

TOP LUCINA SD

- ブラインドビアホール、トレンチ
の埋め込み性に優れる
Excellent performance in
blind via-, trench-filling



孔径: 25μm ビア深さ: 5μmの
ビアに対してフィリングが可能
(アスペクト比0.2)

Can fill 25μm-diameter,
5μm-depth via hole (Aspect ratio: 0.2)

トッフルチナCP/SV/SDは、全ての添加剤成分の定量分析が可能

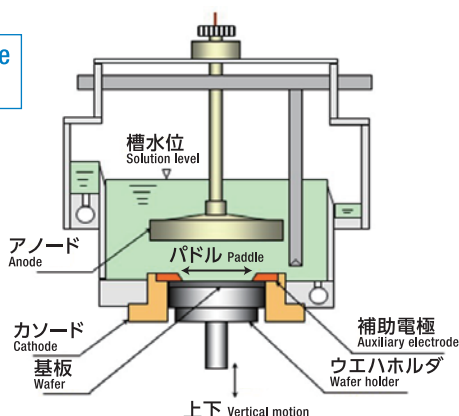
Quantitative analysis is possible for all additives

サポート体制

Support system

- 4~8インチの試作試験が可能(12インチ以上はご相談となります)
Suitable wafer size: 4 to 8 inches (We need discussion over 12 inches.)

Face-up paddle type
plating cell



フェイスアップ式半自動めっき装置 (株式会社東設製)
Face-up paddle model, semi-automatic plating machine (Made by Tosetz Inc.)